

공동개발 계약서

비밀

주식회사 하이닉스반도체와 주식회사 아이피에스는 아래와 같은 조건으로 공동 개발 계약을 체결한다.

- 개발과제명 : **300mm Metal CVD/ALD (Ti/TiN) Process**
- 계약당사자 : 주식회사 하이닉스반도체 (이하 “갑”)
주식회사 아이피에스 (이하 “을”)

제 1 조 (목 적)

본 계약은 “갑”과 “을”이 공동으로 [300mm Metal CVD/ALD (Ti/TiN) Process] 및 대상장비를 개발함에 있어서 필요한 제반사항을 정하는 데 그 목적이 있다.

제 2 조 (개발사양)

1. 본 계약상 공정기술 및 대상장비의 개발 사양(“개발사양”)은 별첨 1 과 같으며, 개발사양의 변경이 요구될 시 양 당사자는 상호 서면 합의로써 개발사양을 추가 또는 변경할 수 있다
2. 전항에 따른 개발사양의 추가 또는 변경으로 인하여 본 계약상 조건들의 변경이 필요한 경우, “갑”과 “을”은 상호 서면 합의로써 관련 계약조건들을 변경할 수 있다

제 3 조 (개발 업무의 수행)

1. 양 당사자는 별첨 1 의 개발사양과 별첨 2 의 개발 역할분담 및 개발일정에 따라 성실히 각각의 개발업무를 수행하여야 한다.
2. 본 계약상 개발업무를 수행하는 도중 일방당사자에게 책임없는 사유로 개발업무 수행의 장애가 발생한 경우, 동 당사자는 타방당사자에게 그러한 사실을 즉시 통지하여야 하고, 양당사자는 상호 협의를 통하여 그러한 장애 요인을 해결하여야 한다. 단, 양당사자간 상호 협의를 통하여 그러한 장애 요인이 해결되지 아니한 경우에, 일방당사자는 타방당사자에게 어떠한 계약 위반 책임없이 서면 통지로 본 계약을 중도 해지할 수 있다.
3. 양 당사자는 본 계약상 개발업무의 원활한 수행을 위하여 개발책임자를 각각 선임, 상

대방에게 통보하고, 선임된 개발책임자는 개발업무의 진척상황 및 개발업무와 관련한 제반 문제의 해결을 위하여 매월 1 회 양당사자가 별도 합의한 장소와 시간에 기술회의를 소집하기로 한다.

제 4 조 (장비의 설치)

1. 본 계약상 개발업무를 위하여 “을”은 “갑”에게 대상장비를 무상 대여 제공기로 하되, 양당사자가 별도 합의에 따라 “갑”이 지정하는 장소에 자신의 책임과 비용으로 대상장비를 설치하고, 본 계약상 개발업무를 즉시 수행할 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 한다
2. 제 1 항에 따라 “갑”이 지정하는 장소에 설치된 경우 “갑”은 “대상장비를 사용함에 있어서 필요한 전력, 용수 등 관련 유틸리티 및 유틸리티 설치 비용, 설치장소를 무상으로 제공하며, 설치된 대상장비를 선량한 관리자의 주의를 다하여 보관, 유지하여야 한다.
3. 본 계약상 개발업무를 수행하는 과정에서 대상장비의 소모성 부품의 교환이 요구되거나, 대상장비의 기계적 결함이 발생한 경우 “을”은 “갑”으로부터 관련 통보를 접수한 즉시 자신의 책임과 비용으로 필요한 조치를 취하여야 한다.
4. “을”이 설치한 장비의 하자로 인하여 “갑”의 장비 및 인원에 손해가 발생하였을 경우 “을”은 이를 배상하여야 한다. 단, “갑”이 제 2 항의 주의의무 및 제 3 항의 통지의무를 다하지 아니하였음을 “을”이 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.

제 5 조 (실시권 허여)

1. 일방당사자는 본 계약에 의거 타방당사자에게 본 계약상 개발업무 수행에 필요한 기술정보(“기술정보”)를 비독점적, 비양도적으로 사용할 수 있는 실시권(제 3 자에 대한 재실시권 제외)을 허여하며, 타방당사자는 동 기술정보를 본 계약의 개발업무 수행 이외의 어떠한 목적으로도 사용할 수 없다.
2. 일방당사자는 본 조에 의거 타방당사자에게 제공되는 자신의 기술정보에 대하여 어떠한 하자 책임도 부담하지 아니한다.

제 6 조 (평 가)

1. 본 계약 별첨 2 의 개발일정에 따라 “갑”은 개발사양에 의거하여 공정기술 및 대상장비에 대한 평가를 실시하여야 하며, “갑”의 평가 결과 대상장비가 개발사양을 충족하고 공정기술에 대한 평가가 완료된 경우 그 결과를 “을”에게 서면 통보하고, 본 계약상 개발업무는 성공적으로 종료된 것으로 간주한다.
2. 전항의 평가 결과 공정기술 및 대상장비가 본 계약상 개발사양을 충족하지 못하는 경우,

“갑”은 “을”에게 즉시 평가 결과를 통보하여야 하고, “을”은 “갑”의 통지를 접수한 날로부터 30 일 이내에 자신의 책임과 비용으로 “갑”의 요청에 따라 필요한 조치를 취하여야 한다.

제 7 조 (기술지원)

1. 본 계약상 개발업무를 수행하기 위하여 일방당사자가 필요한 기술정보 및 관련기술자료를 타방당사자에게 서면으로 요청하는 경우, 타방당사자는 서면요청에 따라 기술정보 및 관련 기술자료를 제공하여야 한다. 단, “갑” 또는 “을”이 제공하는 기술 정보 및 관련 기술 자료는 본 계약에 관련된 공정 기술 및 장비 기술로 제한한다.
2. 전항의 기술지원을 위하여 “갑”이 “을”에게 숙련된 기술자의 파견을 요청하는 경우, “을”은 무상으로 “갑”에게 그러한 기술자를 파견하여야 하며, 기술자 파견에 대한 구체적인 조건들은 각각의 경우에 상호 협의에 의하여 결정하기로 한다.

제 8 조 (개발비)

1. 양당사자간의 별도 서면 합의가 없는 한, 본 계약상 개발업무를 수행과 관련하여 각 당사자에게 발생하는 일체의 개발비용은 각자 부담하는 것으로 한다.
2. “갑”은 본 계약상 개발업무를 수행에 필요한 원자재 비용을 부담하는 것을 원칙으로 하되 “을”은 최초 1 회 source 를 “갑”에게 제공하고 이후 “갑”이 source 를 구매한다.

제 9 조 (개발결과물의 소유권)

1. 본 계약 제 5 조에 의거 일방당사자가 타방당사자에게 제공한 기술정보는 이를 제공한 일방당사자의 소유이며, 동 기술정보에 기초하여 발생된 개량기술, 파생기술 등은 단독 또는 공동 개발의 여부와 관계없이 기술정보의 원소유자가 단독으로 소유한다.
2. 전항의 일반원칙을 제한함이 없이, 본 계약상 개발업무와 관련하여 개발된 공정기술과 관련한 일체의 기술 및 관련 지적재산권(“개발결과물”)은 “갑”이 단독으로 소유하되, 대상장비와 관련된 일체의 기술 및 관련 지적재산권(“개발결과물”)은 “을”이 소유하는 것으로 한다.

제 10 조 (보 증)

각 당사자는 본 계약상 명시적으로 규정된 사항을 제외하고는 본 계약상 개발업무를 수행 및 그 결과에 대하여 타방당사자에게 어떠한 책임도 부담하지 아니한다.

제 11 조 (면 책)

각 당사자는 자신의 기술정보가 제 3 자의 지적재산권을 침해하였음을 이유로 상대방에게 동 제 3 자로부터 클레임 또는 소송이 제기된 경우, 자신의 책임과 비용으로 동 클레임 또는 소송을 방어함과 동시에 이로 인해 상대방이 입은 손해를 전액 배상하여야 한다.

제 12 조 (사업협력)

1. “갑”은 본 계약의 종료 후 “을”에게 본 계약상 공정기술을 구현하는 대상장비의 공급을 요청할 수 있는 권한을 보유하며, “갑”으로부터 그러한 요청이 있는 경우, “을”은 양 당사자간에 상호 별도 협의, 체결하는 최혜고객 조건의 공급계약에 따라 해당 대상장비를 “갑”에게 공급하는 것으로 한다.
2. 제 6 조 1 항에 의한 대상장비 평가 결과가 “갑”의 개발의도를 충족 할 경우 향후 “갑”이 대상장비와 동일하거나 유사한 사양의 장비가 소요시 “갑”은 지속적인 동반자 관계로서 “을”과 최우선적으로 협의하여 상호 최혜조건의 공급계약을 체결하는 것으로 한다.

제 13 조 (기술공개)

1. 각 당사자는 본 계약기간 동안에 직.간접적으로 발생한 결과를 공개적으로 대외에 발표 (구두 혹은 서면)할 경우 반드시 본 기술개발이 “갑”과 “을”의 공동개발에 의해 수행된 것임을 밝혀야 하며, 사전에 상대방에게 공개 내용의 전체를 서면으로 동의를 얻어야 한다.
2. 양 당사자의 합의로 대상장비에 한정된 결과물은 “을”이 외부 고객을 위해 사용할 수 있도록 허용한다.

제 14 조 (비밀유지)

각 당사자는 본 계약의 존재사실, 그 내용 및 본 계약과 관련하여 상대방으로부터 지득하거나 제공받은 모든 기술정보 및 관련 기술자료를 본 계약기간 동안은 물론 그 종료일 (계약이 종료된 사유를 불문한다)로부터 (3)년간은 상대방의 사전 서면동의 없이 제 3 자에게 공개하지 못한다.

제 15 조 (계약기간, 연장 및 해지)

1. 본 계약은 제 3 조 제 2 항 및 본 조 제 3 항 또는 제 4 항에 의거 중도해지 되지 않는 한, 본 계약 체결일로부터 6 개월간 유효하며, 계약기간 만료 30 일전까지 일방당사자가 타방 당사자에 대해 계약해지를 서면으로 통지하지 않는 한, 본 계약은 동일한 조건으로 1 년 씩 자동 연장되는 것으로 한다. 단, 본 계약의 만료일전에 본 계약상 개발업무가 종료

되는 경우, 일방당사자는 타방당사자에게 서면 통지로서 즉시 본 계약을 해지할 수 있다.

2. 제 6 조 1 항에 의거 개발업무가 종료 되었으나, “갑”이 관련 개발업무의 계속적인 진행을 위하여 대상장비가 필요한 경우 “갑”은 대상장비를 구매할 수 있다. 이때 구매조건은 “갑”과 “을”의 기술적인 기여도 및 개발비를 고려하여 양사 협의하에 결정한다.
3. 일방당사자가 본 계약상의 의무를 위반할 경우, 타방당사자는 30 일간의 기간을 정하여 그 의무의 이행을 서면 최고하고 동 기간내에 위반사항을 치유 완료하지 아니할 경우 서면통지로 즉시 본 계약을 해지할 수 있다.
4. 일방당사자는 타방당사자에게 아래의 사유 중 어느 하나가 발생할 경우 서면통지로 즉시 본 계약을 해지할 수 있다.

가. 타방당사자가 발행, 배서, 지급보증 또는 인수한 어음, 수표가 부도처리 되거나 거래 정지된 경우

나. 타방당사자 또는 타방당사자의 중요재산에 대하여 압류, 가압류, 가처분 절차가 개시되는 경우

다. 타방당사자에 대하여 파산, 화의, 청산, 회사정리 절차가 개시되는 경우

라. 타방당사자가 본 계약과 관련한 영업 또는 자산의 중요부분을 양도하는 경우

마. 기타 정상적인 사업활동을 지속하기 어려운 사유가 발생하는 경우

5. 본 계약이 중도해지될 경우, 각 당사자는 즉시 개발업무 수행을 중지하고, 본 계약 제 5 조에 의거 타방당사자로부터 제공받은 모든 기술정보 및 그 복사본을 타방당사자에게 즉시 반환하거나, 타방당사자의 지시에 따라 동 기술정보 및 복사본을 파기하여야 한다.

제 16 조 (장비의 분리· 반출)

본 계약 제 15 조에 따른 계약 만료 또는 해지 후 30 일 이내에 “을”은 자신의 책임과 비용으로 제 4 조에 따라 설치된 대상장비를 설치장소로부터 분리· 반출하여야 한다. 그러한 경우, “갑”은 “을”의 장비 분리· 반출과 관련하여 필요한 협력을 제공하여야 한다.

제 17 조 불가항력

본 계약 체결 후 정부의 조치, 관련 법령의 개폐, 전쟁, 전쟁유사행위, 내란, 폭동, 부품 조달의 장애, 혁명, 천재지변, 화재, 파업, 태업 기타 불가항력적인 사유로 인하여 일방당사자가 본 계약상 의무의 전부 또는 일부를 이행하지 못할 경우에는 상대방에 대하여 그 사실을 즉시 통지하여야 하며, 이 경우 동 불가항력적 사유로 인하여 그 의무이행이 방해받은 당사자는 동 불가항력적 사유가 지속되는 동안 상대방에 대하여 해당 계약의무의 불이행에 대한 책임을 지지 아니한다. 단, 불가항력 사유가 60 일 이상 지속되는 경우, 일방당

사자는 타방당사자에게 서면통보로써 본 계약을 해지 할 수 있다.

제 18 조 (기 타)

1. 각 당사자는 상대방의 사전 서면동의 없이는 본 계약상 자신의 권리의 전부 또는 일부를 타인에게 양도하거나, 타인으로 하여금 자신의 의무를 대행케 하지 못한다. 다만 일방당사자가 그 지분 또는 주식의 50% 이상을 보유하는 법인의 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 본 계약 제 9 조, 제 10 조, 제 11 조, 제 12 조, 제 13 조, 제 14 조 및 그 성질상 효력이 존속되어야 하는 모든 권리·의무는 본 계약의 해지 또는 만료 후에도 존속하는 것으로 한다.
3. 본 계약과 관련하여 발생하는 제반 분쟁사항은 서울지방법원 본원을 전속관할법원으로 하여 소송절차로써 해결한다.
4. 본 계약의 흠결사항 기타 해석과 관련한 사항은 상호 합의하여 결정하며, 합의가 성립하지 아니할 경우에는 상관습에 의하고, 상관습이 존재하지 아니할 경우에는 관련법규에 따른다.
5. 본 계약은 양 당사자의 서면합의 및 기명날인(또는 서명)으로 수정될 수 있다.

양 당사자는 본 계약의 존재 및 그 내용을 증명하기 위하여 본 계약서 2 부를 작성하여 기명날인(또는 서명)한 후 각 1 부씩 보관한다.

2005 년 08 월 17 일

“갑” : 주식회사 하이닉스반도체

경기도 이천시 부발읍 아미리 산 136-1

대표이사 우익제 (인)

“을” : 주식회사 아이피에스

경기도 평택시 지제동 33 번지

대 표 이 사 장 호 승 (인)

별첨 2 . 역할분담 및 개발일정

1.1 역할분담

	하이닉스	아이피에스
역할	<ul style="list-style-type: none"> - Operation 방법 등을 포함한 User 개발 Spec 제공 - 개발 설비의 분석, 평가 및 측정 - 신.구 설비에 대한 Operation Manual등을 포함한 기존 설비관련 정보 제공 - 실장 Test 및 공정 적용 	<ul style="list-style-type: none"> - 설비 제작 및 입고 - 필요시 설비 개조개선 - 설비 Setup 및 Support 지원

※ 개발을 수행하기 위하여 발생하는 비용은 상기 역할분담에 따라 각사의 개발부문에 소요되는 비용에 대하여 각사가 부담하기로 한다.

1.2 개발일정

	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
300mm TiN Module(1ea) + B/B 반입	→									
300mm Ti Module(1ea) 반입		→								
CVD/ALD TiN Process Setup		→								
CVD/ALD Ti Process Setup			→							
CVD/ALD Ti/TiN Process Qual				→				→		

2.

(1)

(2)

3. 비밀

(1) 정보

안규

자는

로 동

(2) 정보자

보수 령